

FPPR-200,400

ETCHING RESIST

**FPPR-
200,400**

ご使用上の注意：保存は温度10～20℃の冷暗所に保管して下さい。感光液及びシンナーは可燃性有機溶剤を含んでいますので、ご使用に当たり火気及び換気には充分注意して下さい。

Caution : Keep FPPR in a dark place at 10～20℃.
The resist and the thinner contain flammable solvent.

1. 特長

- 1) FPPR-200,400 はポジ型フォトレジストで耐酸性に優れ高解像度が得られプリント基板の製造などに適しています。
- 2) FPPR-200,400 は弱アルカリ水溶液で現像ができますので作業性に優れています。

2. 使用方法

- 1) 表面処理
 - 金属板上の脱脂、脱錆を完全に行ってください。弊社のネオキューブロン（水で5～10倍に希釈）で脱脂した場合は弱アルカリ水（2%アンモニア水）で中和して下さい。脱脂後は充分水洗を行ってください。
- 2) コーティング
 - ホエラー、スピナー、ディップ、スプレー等のコーティング方法が使用できます。
- 3) プレバーク
 - 熱風恒温乾燥器中、80～100℃、10～20分又はホットプレート上、80～100℃、2分
- 4) 露光
 - コダック フォトグラフィック ステップタブレットNO. 2を用いて3～4段が抜けるところを適性露光時間とします。
- 5) 現像
 - FPPR現像液（原液）1に対し水5の割合で希釈して常温で1～2分で現像できます。
- 6) ポストバーク
 - ポストのバークをすると耐腐食性が向上します。熱風恒温乾燥器中、120～150℃、10～20分又はホットプレート上、120～150℃、2～3分
- 7) エッチング
 - 通常通り
- 8) 剥膜
 - 苛性ソーダ（5～10%水溶液）又はアルコール、ケトン等の有機溶剤で剥膜して下さい。

3. 販売単位

500mℓ

4. 種別、危険等級

品名	種別第4種	危険等級
FPPR-200,400	第2石油類	Ⅲ
FPPRシンナー	第2石油類	Ⅲ

1. Characteristics

- 1) FPPR-200,400 is a positive working photoresist intended for metal and PCB etching. It has excellent chemical resistance and high resolution.
- 2) FPPR-200,400 is can be developed with a diluted alkaline aqueous solution.

2. Process

- 1) Surface treatment
 - Thoroughly degrease and remove rust from a metal surface. If our Neocupron is used for degreasing (diluted with water at 1 : 5～10), neutralize with 2% ammonia aqueous solution.
- 2) Coating
 - Many coating methods such as whirler, spinner, dip or spray are applicable.
- 3) Prebaking
 - In a hot air oven at 80～100℃ for 10～20min.or
 - On a hotplate at 80～100℃ for 2 min.
- 4) Exposure
 - Optimum exposure time is fixed by exposing the layer through a Kodak Photographic Step Tablet NO.2 (Gray-Scale) to be cleared up to 3～4 steps when developed.
- 5) Development, Rinse
 - Develop with FPPR-Developer (diluted with water at 1 : 5) for 1～2min. Rinse with water.
- 6) Postbaking
 - When stronger chemical resistance is required, heat the developed layer in a hot air oven at 120～150℃ for 10～20min. or on a hot plate at 120～150℃ for 2～3min.
- 7) Etching
 - As usual.
- 8) Removal
 - Remove the layer with a 5～10% caustic soda aqueous solution, ketones or ester solvents.

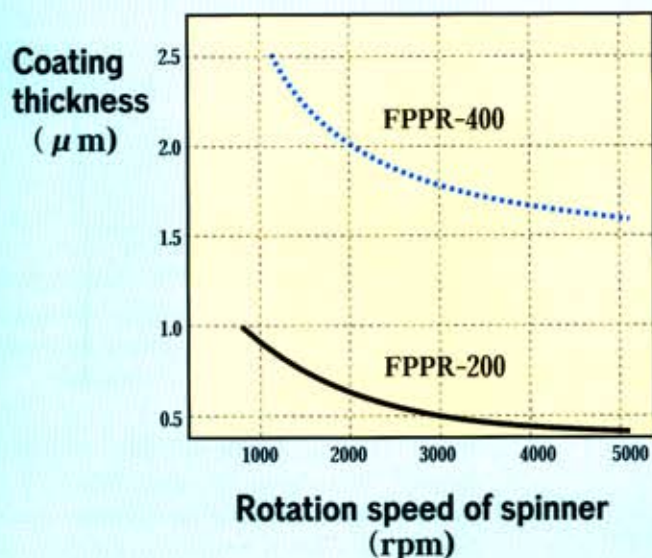
3. Containers

500mℓ



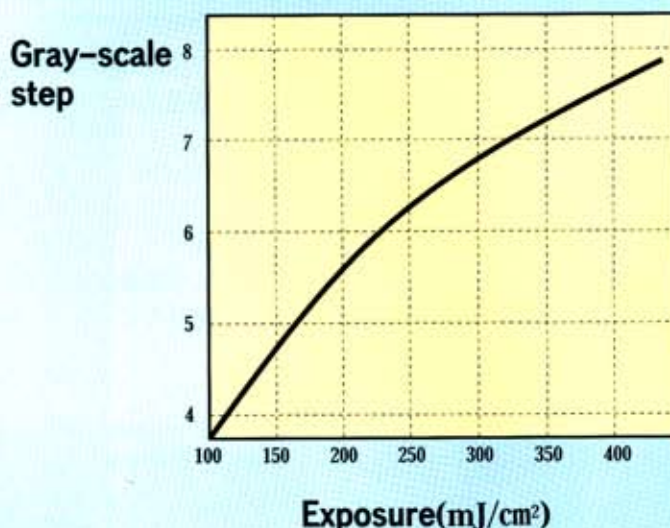
回転数と膜厚の関係

Relation between rotation speed and coating thickness.



露光時間とグレースケール感度の関係

Sensitivity characteristic curve.



Light Source: Ultra-high-pressure mercury lamp.
 Distance: 1m, Coating thickness: 2.6 μm
 Intensity: 320~390nm(center, 350nm) 1.77mW/cm²
 330~490nm(center, 420nm) 6.60mW/cm²
 Development: 60sec. at 25°C

製品規格 Specifications

	FPPR-200	FPPR-400
粘度 viscosity (mPa·s/25°C)	8.5 ± 1.0	72.5 ± 2.5
比重 specific gravity(25°C)	0.980 ± 0.002	1.036 ± 0.002

分光感度 Spectral sensitivity

